

2024年中国HBM行业市场现状分析及未来趋势研 判报告

报告大纲

智研咨询

www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2024年中国HBM行业市场现状分析及未来趋势研判报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1195346.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

《2024年中国HBM行业市场现状分析及未来趋势研判报告》对HBM概述、HBM产业链及关键工艺分析、全球HBM市场现状、全球HBM市场格局、中国HBM行业发展现状、中国HBM行业竞争格局及重点企业、中国HBM行业投资前景、中国HBM行业发展趋势等进行了深入的分析。《2024年中国HBM行业市场现状分析及未来趋势研判报告》意在为HBM市场相关参与者以及有意愿进入HBM相关产业的投资者、研究者等，提供一个了解HBM市场现状及趋势的全面视野。《2024年中国HBM行业市场现状分析及未来趋势研判报告》对HBM行业做出全面梳理和深入分析，是智研咨询多年连续追踪、调研和分析成果的呈现。

报告目录：

第1章 HBM行业相关概述分析 10

- 1.1 存储芯片基本情况 10
- 1.2 HBM定义及结构 11
- 1.3 HBM技术优势 12
- 1.4 HBM行业进入壁垒 13
 - 1.4.1 技术壁垒 13
 - 1.4.2 资金、规模壁垒 13
 - 1.4.3 人才壁垒 14
 - 1.4.4 客户壁垒 14
- 1.5 HBM行业发展痛点 14
 - 1.5.1 成本高昂 14
 - 1.5.2 良率偏低 15
 - 1.5.3 散热问题 15
 - 1.5.4 技术难度高 15

第2章 HBM产业链及关键工艺分析 16

- 2.1 HBM产业链图谱 16
- 2.2 HBM产业封测端 16
 - 2.2.1 HBM封装结构 16
 - 2.2.2 TSV（硅通孔）技术 17
 - 2.2.3 Bumping（凸块制造）技术 20
 - （1）凸点制造技术 20
 - （2）混合键合技术 21

2.2.4 Stacking (堆叠) 技术 23

(1) MR-RUF技术 23

(2) TC-NCF技术 25

2.2.5 CoWoS技术 26

2.2.6 FC技术分析 27

2.3 HBM产业设备端 28

2.3.1 半导体设备市场规模 28

2.3.2 HBM生产制造所需设备 29

2.4 HBM产业材料端 32

2.4.1 电镀液 32

2.4.2 环氧塑封料 (EMC) 34

2.4.3 光敏聚酰亚胺 (PSPI) 36

2.4.4 封装基板 37

2.4.5 CXL 39

2.5 HBM产业应用端 40

2.5.1 人工智能市场现状 40

2.5.2 AI芯片市场现状 42

第3章 全球HBM市场现状分析 46

3.1 全球存储芯片行业发展现状 46

3.1.1 存储芯片发展历程 46

3.1.2 存储芯片市场规模 47

3.2 全球HBM行业发展历程 49

3.3 全球HBM市场规模 51

3.4 全球HBM市场结构 52

3.5 主要地区HBM发展现状 53

3.5.1 北美地区HBM发展现状 53

(1) 美国相关政策 53

(2) 市场规模 53

3.5.2 亚太地区HBM发展现状 54

(1) 韩国相关政策 54

(2) 日本相关政策 55

(3) 市场规模 56

3.5.3 欧洲地区HBM发展现状 56

(1) 相关政策 56

(2) 市场规模 57

第4章 全球HBM市场格局分析 58

4.1 全球HBM企业竞争格局 58

4.2 全球HBM行业重点企业分布 58

4.2.1 韩国SK海力士 58

(1) 公司基本情况 58

(2) 公司经营业绩 59

(3) 公司HBM业务布局 60

(4) 公司HBM产线投资建设情况 62

4.2.2 韩国三星电子 62

(1) 公司基本情况 62

(2) 公司经营业绩 63

(3) 公司HBM业务布局 64

(4) 公司HBM产线投资建设情况 65

(5) 公司HBM业务发展面临的挑战 65

4.2.3 美国美光科技 65

(1) 公司基本情况 65

(2) 公司经营业绩 66

(3) 公司HBM业务布局 68

(4) 公司HBM产线投资建设情况 69

(5) 公司HBM业务发展面临的挑战 69

第5章 中国HBM行业发展现状分析 70

5.1 中国HBM行业政策分析 70

5.1.1 国家层面HBM行业相关政策 70

5.1.2 地区层面HBM行业相关政策 72

5.1.3 政策对HBM行业的影响 74

5.2 中国HBM行业市场规模 74

5.3 中国HBM行业技术动态 75

第6章 中国HBM行业竞争格局及重点企业分析 78

6.1 中国HBM行业企业格局 78

6.2 中国HBM行业重点企业分析 79

6.2.1 苏州赛腾精密电子股份有限公司 79

- (1) 公司基本情况 79
- (2) 公司经营业绩 79
- (3) 公司HBM相关产品布局 80
- (4) 公司未来发展计划 80
- 6.2.2 江苏雅克科技股份有限公司 81
 - (1) 公司基本情况 81
 - (2) 公司经营业绩 82
 - (3) 公司HBM相关产品布局 83
 - (4) 公司未来发展计划 84
- 6.2.3 通富微电子股份有限公司 84
 - (1) 公司基本情况 84
 - (2) 公司经营业绩 85
 - (3) 公司HBM相关产品布局 86
 - (4) 公司未来发展计划 87
- 6.2.4 紫光国芯微电子股份有限公司 87
 - (1) 公司基本情况 87
 - (2) 公司经营业绩 87
 - (3) 公司HBM相关产品布局 89
 - (4) 公司未来发展计划 90
- 6.2.5 江苏华海诚科新材料股份有限公司 91
 - (1) 公司基本情况 91
 - (2) 公司经营业绩 91
 - (3) 公司HBM相关产品布局 93
 - (4) 公司未来发展计划 93
- 6.2.6 拓荆科技股份有限公司 94
 - (1) 公司基本情况 94
 - (2) 公司经营业绩 96
 - (3) 公司HBM相关产品布局 97
 - (4) 公司未来发展计划 98
- 6.2.7 江苏联瑞新材料股份有限公司 99
 - (1) 公司基本情况 99
 - (2) 公司经营业绩 99
 - (3) 公司HBM相关产品布局 100
 - (4) 公司未来发展计划 101
- 6.2.8 武汉新芯集成电路股份有限公司 101

- (1) 公司基本情况 101
- (2) 公司HBM相关产品布局 102
- (3) 公司未来发展计划 102

- 第7章 中国HBM行业投资前景分析 103
 - 7.1 中国HBM行业发展机遇 103
 - 7.1.2 市场需求旺盛 103
 - 7.1.2 政策大力扶持 105
 - 7.1.3 企业加大研发投入 105
 - 7.2 中国HBM行业发展面临挑战 106
 - 7.2.1 海外对我国实施技术封锁 106
 - 7.2.2 产业整体发展水平远落后于发达国家 107
 - 7.3 中国HBM行业投资机会分析 108
 - 7.3.1 产业链投资机会 108
 - 7.3.2 其余投资方向 108
 - (1) 主流DRAM产品供不应求 108
 - (2) 国内利基型存储芯片厂商迎来发展机会 109
 - 7.4 中国HBM行业投资风险分析 110
 - 7.4.1 政策变动风险 110
 - 7.4.2 贸易摩擦风险 110
 - 7.4.3 技术研发不及预期风险 110
 - 7.4.4 市场竞争加剧风险 111
 - 7.4.5 AI技术发展不及预期风险 111

- 第8章 中国HBM行业发展趋势分析 112
 - 8.1 HBM行业发展趋势分析 112
 - 8.1.1 HBM将会迎来更广泛的应用 112
 - 8.1.2 HBM性能不断优化 112
 - 8.1.3 HBM产品走向“定制化” 113
 - 8.1.4 HBM技术与其他技术融合发展 113
 - 8.2 2024-2030年HBM行业市场规模预测 114
 - 8.2.1 全球HBM市场规模预测 114
 - 8.2.2 中国HBM市场规模预测 114

图表目录:

- 图表 1：存储器分类 10
- 图表 2：DDR、GDDR、LPDDR主要区别对比 11
- 图表 3：HBM结构图 12
- 图表 4：HBM在带宽、功耗方面具备明显优势 13
- 图表 5：HBM产业链 16
- 图表 6：HBM结构图及用到的封装工艺 17
- 图表 7：HBM 封装成本拆分 18
- 图表 8：TSV的工艺流程 19
- 图表 9：TSV工艺成本分布 20
- 图表 10：Bumping工艺流程 21
- 图表 11：使用微凸点连接和使用混合键合连接的HBM高度对比 22
- 图表 12：混合键合两种技术类型 23
- 图表 13：MR-MUF技术散热性能优异 24
- 图表 14：HBM堆叠技术对比 25
- 图表 15：2023-2024年全球CoWoS产能（单位：万片/月） 27
- 图表 16：2019-2023年全球半导体设备销售额（单位：亿美元） 28
- 图表 17：2022-2023年全球主要地区半导体设备销售额（单位：亿美元） 29
- 图表 18：HBM各环节设备需求 31
- 图表 19：2021-2024年全球半导体电镀化学品市场规模（单位：亿美元） 32
- 图表 20：2023年全球半导体电镀化学品市场规模分布 33
- 图表 21：截至2024年上半年国内企业布局先进封装用电镀液情况 34
- 图表 22：2020-2023年全球半导体环氧模塑料(EMC)市场规模（单位：亿美元） 35
- 图表 23：CoWoS工艺RDL布线中的PSPI 37
- 图表 24：2019-2023年全球封装基板市场产值（单位：亿美元） 38
- 图表 25：2023年全球封装基板市场产值结构 38
- 图表 26：Type 3 CXL设备 39
- 图表 27：2021-2023年全球人工智能IT支出（单位：亿美元） 41
- 图表 28：国内外部分企业发布大模型参数 41
- 图表 29：2022-2025年全球AI芯片收入（单位：亿美元） 43
- 图表 30：DRAM带宽、互连带宽的增长远小于硬件计算能力的增长 44
- 图表 31：市场上主流GPU和存储类型 44
- 图表 32：2020-2023年全球存储芯片市场规模（单位：亿美元） 48
- 图表 33：2023年全球存储芯片市场结构 48
- 图表 34：HBM产品演进历程 50
- 图表 35：2022-2023年全球HBM需求量（单位：亿GB） 51

- 图表 36：2020-2023年全球HBM市场规模（单位：亿美元） 52
- 图表 37：2022-2023年全球HBM市场需求结构 53
- 图表 38：2020-2023年北美HBM市场规模（单位：亿美元） 54
- 图表 39：2020-2023年亚太HBM市场规模（单位：亿美元） 56
- 图表 40：2020-2023年欧洲HBM市场规模（单位：亿美元） 57
- 图表 41：2023年全球HBM企业竞争格局 58
- 图表 42：2016-2024年上半年SK海力士经营业绩 59
- 图表 43：2024年上半年SK海力士营收结构 60
- 图表 44：SK海力士HBM产品 62
- 图表 45：2016-2024年上半年三星电子经营业绩（单位：万亿韩元） 63
- 图表 46：2022-2023年三星电子公司各业务营收情况（单位：万亿韩元） 64
- 图表 47：美光科技部门架构 66
- 图表 48：2019-2024财年美光科技营业收入及净利润（单位：亿美元） 67
- 图表 49：2021-2024财年美光科技各产品营收（单位：亿美元） 67
- 图表 50：美光科技HBM产品 69
- 图表 51：国家层面HBM行业相关政策 71
- 图表 52：地区层面HBM行业相关政策 72
- 图表 53：2020-2023年中国HBM市场规模（单位：亿元） 75
- 图表 54：中国HBM行业部分重点专利申请情况 76
- 图表 55：国内HBM产业链环节设计企业 78
- 图表 56：2021-2024年上半年赛腾股份营收及净利润（单位：亿元） 79
- 图表 57：2022-2023年赛腾股份营收结构（单位：亿元） 80
- 图表 58：截至2023年末雅克科技主要产品产能 81
- 图表 59：2021-2024年一季度雅克科技营收及净利润（单位：亿元） 82
- 图表 60：2022-2023年雅克科技营收结构（单位：亿元） 83
- 图表 61：2021-2024年一季度通富微电营收及净利润（单位：亿元） 85
- 图表 62：2021-2023年通富微电集成电路封装测试营收及销量（单位：亿块，亿元） 86
- 图表 63：2021-2024年一季度紫光国微营收及利润（单位：亿元） 88
- 图表 64：2022-2023年紫光国微营收结构（单位：亿元） 88
- 图表 65：2021-2023年紫光国微集成电路产销量（单位：亿颗） 89
- 图表 66：2021-2023年紫光国微研发投入（单位：亿元） 90
- 图表 67：2021-2024年一季度华海诚科营收及净利润（单位：亿元） 91
- 图表 68：2023年华海诚科营收结构（单位：万元） 92
- 图表 69：2019-2023年华海诚科环氧塑封料产销量（单位：万吨） 92
- 图表 70：2021-2024年一季度华海诚科研发投入（单位：万元） 93

图表 71：拓荆科技产品系列 95

图表 72：2021-2024年一季度拓荆科技营收及净利润（单位：亿元） 96

图表 73：2023年拓荆科技营收结构（单位：亿元） 97

图表 74：2023年拓荆科技产品销量（单位：台） 98

图表 75：2021-2024年一季度联瑞新材营收及净利润（单位：亿元） 100

图表 76：2023年联瑞新材产品营收及产销量（单位：万吨，亿元） 100

图表 77：武汉新芯业务结构 102

图表 78：2020-2023年中国人工智能核心产业规模（单位：万亿元） 104

图表 79：2021-2023年中国AI芯片市场规模（单位：万张） 105

图表 80：2024-2030年全球HBM市场规模预测 114

图表 81：2024-2030年中国HBM市场规模预测 115

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1195346.html>